



# Co-ordination of microelectronics packaging and interconnection projects environment and trends for the development of European solutions



Pays :	Intergouvernemental
Création :	15-12-1997
Fin d'activité :	15-05-2002
Site Web :	<a href="http://www.compete.tm.fr/">http://www.compete.tm.fr/</a> (Date de consultation du site : 2002-12-10) (Site <b>archivé par la BnF</b> depuis le 13/04/2001)
Note :	Réseau de recherche et développement, financé par la Commission des Communautés européennes (DG XIIC)
Autres formes du nom :	COMPETE COMPETE thematic network Coordination of microelectronics packaging and interconnection projects environment and trends for the development of European solutions

**Co-ordination of microelectronics packaging and interconnection projects environment and trends for the development of European solutions : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr)**

**Œuvres textuelles (1)**

"Proceedings of the 2nd International conference on benefiting from thermal and mechanical simulation in (micro)-electronics"    
(2001)

de International conference on benefiting from thermal and mechanical simulation in (micro)-electronics (02 ; 2001 ; Paris)

*avec Co-ordination of microelectronics packaging and interconnection projects environment and trends for the development of European solutions comme Éditeur scientifique*

**Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr)**

**À la BnF (1)**

Notice correspondante dans Catalogue général

**Sur le Web (1)**

Notice correspondante dans VIAF